# **关于印发《宝安区关于促进半导体与集成电路产业发展的若干措施》的通知**

发布日期：2023-08-02  浏览次数：1472

各街道办事处，区各有关单位：

　　《宝安区关于促进半导体与集成电路产业发展的若干措施》已经区政府同意，现予印发，请认真贯彻执行。

　　特此通知。

深圳市宝安区发展和改革局

2023年7月23日

**宝安区关于促进半导体与集成电路产业发展的若干措施**

　　为贯彻落实粤港澳大湾区和深圳先行示范区“双区驱动”战略，抢抓重大历史机遇，聚焦半导体与集成电路产业集聚和创新发展，现根据国家发展改革委、科技部、工信部、财政部《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》、《深圳市人民政府关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》和《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022—2025年）》有关规定，结合我区实际，制定本措施。

**一、提升制造、封测环节核心竞争力**

　　重点引进和支持先进封测、核心设备及零部件、关键材料研发及产业化项目，以重点项目为牵引，吸引产业链上下游企业集聚发展。

**第一条 推动重点项目落地。**对落户我区的半导体与集成电路重点项目，按照固定资产投资金额（不含地价）的20%给予补助，单个企业最高不超过3000万元。

**第二条 突破核心设备及零部件、关键材料。**大力培育引进半导体与集成电路设备及材料企业，开展核心设备及零部件、关键材料的研发及产业化。对于首台(套)关键设备及零部件、首批次新材料进入重点集成电路制造企业供应链，获得市奖励的，按照市资助金额的20%给予配套支持。

**第三条 鼓励企业间验证服务。**鼓励集成电路制造企业为区内设备、材料企业提供首台(套)关键设备及零部件、首批次新材料验证服务。对于所验证设备及零部件、材料列入工信部、广东省、深圳市相关推广目录的，按照验证设备及零部件、材料价格20%，分别给予提供验证方最高不超过100万元（设备及零部件类）、50万元（材料类）补助。

**第四条支持企业开展车规级认证。**鼓励芯片企业针对车载应用的芯片进行严格的质量与可靠性确认，特别是对产品功能和性能进行标准规范测试，打造自主可控的国产芯片供应链体系。对集成电路设计及模组企业产线或产品通过AEC-Q100（集成电路）汽车电子车规级认证，给予每家企业实际认证费用20%、最高100万元的一次性补贴。

**二、推动设计环节关键技术突破**

　　鼓励企业开展集成电路设计、流片验证及EDA工具软件研发，进一步推动形成完整芯片制造闭环。

**第五条 支持企业购买或租赁软件工具。**支持集成电路企业购买IP、EDA工具软件开展集成电路研发。对企业购买IP、购买或租赁国产EDA工具软件，获得市资助的，按照市资助金额的20%给予配套支持。

**第六条 支持企业开展流片验证。**对集成电路企业开展多项目晶圆（MPW）流片验证、首次完成全掩膜工程产品流片，获得市奖励的，按照市资助金额的20%给予配套支持。

**第七条加快EDA核心技术攻关。**对开展先进工艺制程、新一代智能、超低功耗等集成电路EDA工具软件研发的企业，按照EDA工具软件研发费用的20%给予补助，每个企业最高不超过500万元。

**三、强化科技创新策源功能**

　　通过市区产业政策叠加，加大科技创新平台建设、关键技术攻关支持力度，为产业可持续发展提供科技支撑。

**第八条 提高科技创新能力。**鼓励境内外企业、高校和科研机构共同建设科技创新平台，开展核心技术攻关。对经国家部委、省、市认定的半导体与集成电路领域各类科技、产业创新平台，获得市奖励的，按照市资助金额的20%给予配套支持。对承担国家部委、省、市开展的集成电路领域重大技术攻关及重点研发计划，获得市奖励的，按照市资助金额的20%给予配套支持。

**四、完善产业空间保障体系**

　　从工业厂房和办公场地的租赁费用着手，进一步优化产业用房资源配置，切实减轻企业经营负担。

**第九条 加大空间保障力度。**对新引进的集成电路设计企业，在我区租赁研发、办公用房的，前3年分别按照房屋租赁参考价格的70%、50%、50%给予租金补贴，每个企业每年度不超过200万元；对新引进的集成电路关键设备、核心材料、封装测试、生产制造重点企业，在我区租赁生产制造厂房的，前3年分别按照房屋租赁参考价格的70%、50%、50%给予租金补贴，每个企业每年度不超过500万元；对新引进的半导体及元器件分销营收全国排名前三十的企业，在我区租赁办公、仓储用房的，前3年分别按照房屋租赁参考价格的50%、50%、30%给予补贴，每个企业每年度不超过50万元。宝安区半导体与集成电路产业园区、创新型产业用房、工业保障房租金补贴与本措施租金补贴由企业按自主选择申报，不重复资助。

**五、构建高质量人才保障体系**

　　与市、区人才政策衔接，引进和留住一线研发人员、技术人员以及管理人员。

**第十条 强化核心团队激励。**对年度营业收入首次突破一定数额的集成电路EDA、IP、设计、制造、封装测试、关键装备和材料企业，获得市奖励的团队，按照市资助金额的20%给予配套支持。

**第十一条构建专业人才体系。**建设高水平、创新力的半导体与集成电路行业人才队伍，将重点企业优秀人才纳入“凤凰英才计划”，实现高层次人才子女入学、人才安居、医疗保健、金融服务等多方面服务保障“一卡通”。推进“首席工程师工作室”建设，按有关政策给予支持和奖励，以点带面打造宝安区半导体与集成电路产业工程师强队。

**六、附则**

**第十二条** 本措施适用集成电路设计、制造、封装测试、设备、材料、分销企业，或提供相关集成电路产业服务的企业、机构或组织。本措施重点支持高端通用芯片、专用芯片和核心芯片等芯片设计；硅基及第三代半导体集成电路制造；高端电子元器件制造；晶圆级封装、三维封装、Chiplet（芯粒）等先进封装测试技术；EDA工具、关键IP核技术开发与应用；光刻、刻蚀、离子注入、沉积、检测设备等先进装备及关键零部件生产；以及核心半导体材料研发和产业化。

**第十三条** 对由区政府确定的半导体与集成电路重点项目，需突破本措施规定的扶持政策的，按程序报区政府另行审定；重点项目已享受市、区相关政策支持的，本措施不再予以重复支持。

**第十四条** 本措施扶持对象为已登记注册，且实际经营的独立法人单位。本措施与区级其他同类优惠措施、前海合作区同类优惠措施，由企业按自主选择申报，不重复资助。所需资金按照区科技与产业发展专项资金预算进行总额控制。

**第十五条** 本措施自2023年8月10日起实施，有效期3年，由宝安区发展和改革局负责解释，本措施相关的操作规程、申报指南等由宝安区发展和改革局另行制定；执行期间如遇国家、省、市有关政策及规定调整的，本措施可进行相应调整。